

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

03-258476

(43) Date of publication of application: 18.11.1991

(51)Int.CI.

B23K 26/00

(21)Application number: 02-055324

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

07.03.1990

(72)Inventor: NISHIKAWA YUKIO

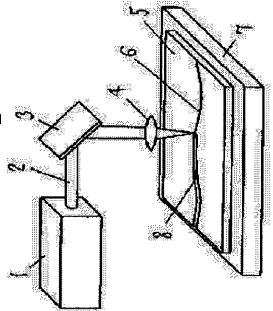
UESUGI YUJI

KURIYAMA KATSUHIRO SHIOYAMA TADAO

(54) LASER CUTTING METHOD AND DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To cut glass to an arbitrary shape without requiring a cutting width by forming a continuous marking-off line on at least one surface of the glass and irradiating the marking-off line with a laser beam. CONSTITUTION: The laser beam 2 emitted from a CO2 laser oscillator 1 is made incident on a condenser lens 4 by a reflecting mirror 3 and the glass plate 5 is irradiated thereupon with this laser beam. An X-Y table is moved in such a manner that the laser spot comes into the marking-off line 6 of the desired shape, by which the glass plate 5 is cut to a prescribed shape. The cutting line 8 is progressed by the movement of the laser spot at this time but the cutting mechanism is contributed by the elastic distortion arising form a local temp, rise and, therefore, the propagation of a crack arises behind the position irradiated with the laser. The crack is more easily generated by the effect of residual strains if the marking-off line is formed by mechanical means.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本 国特 許 庁 (JP)

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-258476

⑤Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)11月18日

B 23 K 26/00

320 E

7920-4E

審査請求 未請求 請求項の数 8 (全4頁)

69発明の名称

レーザ切断方法および装置

幸 男

(21)特 願 平2-55324

裕

22出 願 平2(1990)3月7日

西 何発 明 者 @発 明 者 植 杉 雄 @発 明 者 栗 Ш 勝 @発 明 者 塩山 忠夫 松下電器産業株式会社 の出 願 人

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地

個代 理 人 弁理士 栗野 外1名 重孝

Ж

明

1、発明の名称

レーザ切断方法および装置

2、特許納求の範囲

- (1) ガラスの少くとも片方の面に連続した緊害き 線を形成し、野鬱き線上にレーザ光を照射するレ ーザ切断方法。
- (2) ガラス表面が溶触する前にレーザ・スポット を移動させる特許請求の範囲第1項記載のレーザ 切断方法。
- (3) 前記レーザの波長が4μm以上である特許額 求の範囲第1項記載のレーザ切断方法。
- (4) 前記野書き線は機械的手段によって形成され る特許請求の範囲第1項記載のレーザ切断方法。
- (5) 前記レーザ光は連続発振レーザ想から出射さ れる特許請求の範囲第1項記載のレーザ切断方法。
- (6) 野書き線を形成した面とは反対の方向からレ ーザを照射する特許請求の範囲第1項記載のレー ザ切断方法。
- (7) ガラス表面に罫審き線を形成する罫 き装置

と、レーザ光の集光装置と、野書き点の移動に追 従してレーザ光が野春き線上で移動する移動装置 とを備えたレーザ切断装置。

前記事書き装置と集光装置は中心からの距離 が等しくなるように回転機構上に設けられた特許 請求の範囲第7項記載のレーザ切断装置。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明はレーザ光を用いたガラスの切断方法お よび装置に関するものである。

従来の技術

以下図面を参照しながら、上述した従来のガラ スのレーザ切断方法および装置について説明す

第5図は従来のガラスのレーザ切断方法および 装置の構成図を示す。第5回において、14は レーザ発振器、15はレーザ・ビーム、16は反 射鏡、17は集光レンズ、18はガラス板、19 はX-Yテーブル、20は切断線である。レーザ 発版器14から出射されたレーザ・ビーム15は

果光レンズ17によってガラス板18上に集光され、同時に X - Y テーブル19によって移動される。レーザ発振器14に炭酸ガス・レーザを用た場合、ガラス材料は、このレーザの波長10.6μmに対する吸収率が高いため、ガラス板18のレーザ光15が照射された部分は溶融し切断を印を加る。また、レーザ発振器14に Y A G レーザを用いた場合、ごのレーザの波長1.0 βμmに対するがラスの吸収率は一般に低いが、無部ら(昭和するガラスの酸工学会春季大会学術講演会評演和文を表したが示されている。

発明が解決しようとする課題 ・

しかしながら上記従来法のうち、炭酸ガス・レーザを用いたガラスの切断方法では、ガラス材料がレーザ光を吸収し、熱加工によって、溶融し切断される。したがって所定の切断幅を必要とし、また切断部周辺にだれや熱影響部が生じるため、加工精度が十分でなく、さらに残留熱応力によって切断部周辺に割れが発生するという課題を

有していた。

またYAGレーザを用いた方法では、がラスのの中で、切断可能ながラス材料が限られてる。なが、のいまた、裏面に蒸着膜等の他層が存在する場合には、ガラスを透過したレーザ光によって、蒸放したという課題のあることが判すするといいでき、しかも裏面に他層が存在する場合もととができ、しかも裏面に他層が存在する場合とと必要な加工を施さないガラスのレーザ切断方法を提

課題を解決するための手段

供するものである。

上記問題点を解決するために本発明のガラスのレーザ切断方法は、ガラスの少くとも片方の面に連続した野春き線を形成し、野春き線上にレーザ光を照射しガラスを切断するもので、野春きとレーザ切断を一台の装置で行なうために、野春き線上で移動するように、野春き装置と集光装置と移動装置と

を備えたものである。

作 用

実 施 例

以下本発明の実施例におけるガラスのレーザ切断方法および装置について、図面を参照しながら 説明する。

第 1 図は本発明の第 1 の実施例におけるガラスのレーザ切断方法の構成図を示すものである。第

1 図において、1 は連統発振の炭酸ガス・レーザ 発振器、2はレーザ光、3は反射鏡、4は集光レ ンズ、5はガラス板、6は野春き線、7はX-Y テーブル、8は切断線である。炭酸ガス・レーザ 発振器1から出たレーザ光2は、反射鏡3によっ て集光レンズ4に入射され、ガラス板5上に照射 される。目的の形状の罫書き線 6 上にレーザ・ス ポットが来るようにX-Yテーブルを移動させる ことによって、ガラス板5を所定の形状に切断す ることができる。ガラス板5の厚さが1㎜の場 合、加工点のパワー密度を25~50w/cdとす ると、切断速度10mm/秒を得ることが出来た。 切断線8はレーザ・スポットの移動により進行す るが、切断の機構が局部的温度上昇にともなう弾 性的ひずみに寄因するものであるため、き裂の伝 幡はレーザ照射位置よりも後方で発生する。野 き線の形成方法としては機械的手段による方が残 留ひずみによる効果で、き裂の発生が容易となる 傾向がみられた。また、レーザ光の照射方向は、

き線上に照射した方が、裏面から照射するよ

りもき裂の発生が容易となる傾向がみられた。

第2回は本発明の第2の実施例におけるガラス レーザ切断装置の構成図を示すものである。 第2 図において、9はダイヤモンド・カッターである。 ダイヤモンド・カッター 9 の顕書き点にレーザ加工点が追従するように X ー Y テーブルン を でゆの矢印の方向に移動させると、 ダイヤモン で で の 5 年 8 6 上に 限 射される こととなる。

以上のように、緊害き点にレーザ加工点が追従 : するようにガラス板を移動させることで、緊害き とレーザ切断とを一工程で行える。

また、第2の実施例において、移動装置として X - Y テーブルでガラス板を移動させたが、 軽書 き装置とレーザ集光装置を移動させる方式でも良 く、この場合には曲線の切断も可能となる。

第3図は本発明の第3の実施例におけるガラスのレーザ切断装置の機成図を示すものである。第3図において、10は回転機構、11と12は反

4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例におけるガラスのレーザ切断方法の構成図、第2図は本発明の第2の実施例におけるガラスのレーザ切断装置の構成図、第3図は本発明の第3の実施例におけるガラスのレーザ切断装置の構成図、第5図は従来のガラスのレーザ切断方法および装置の構成図である。

1 …… 炭酸ガス・レーザ発振器、 4 … … 集光レ

第4図は本発明の第4の実施例におけるガラスのレーザ切断装置の構成図を示すものである。第4図において、13はガラス管である。第4の次 施例が第3の実施例と異なるのは、野春きなのは、野春きなりに果光レンズ4とダイヤモンド・カッター 9を配置した点で、このような構成によって、ガラス管を内面から切断することが出来る。

発明の効果

ンズ、 5 …… ガラス板、 6 …… 野害き線、 8 …… 切断線、 9 …… ダイヤモンド・カッター、 1 0 … … 回転機構、 1 1 … … 反射鏡、 1 3 … … ガラス 管。

代理人の氏名 弁理士 粟野重孝 ほか1名

